

EPTA Meeting Record

Date	Place	Speaker	Topics
2005. 12. 6	池袋いらか	宮代文夫	IMAPS2005報告
2006. 8. 2	池袋ルノワール	傳田精一	最近の実装技術
2007. 3. 9	池袋ルノワール	相良岩男 遠藤正徳	半導体よもやま話 新しい実装関連ポリマー材料
2007. 6. 12	池袋ルノワール	高田清司	大口径Siウエハと太陽電池用ウエハ
2007. 8. 3	池袋ルノワール	藤江明雄 宮代文夫	電子デバイスと静電気 EMPC2007参加報告
2008. 8. 26	市ヶ谷セミ会議室	田畑晴夫 林秀臣	実装と接着 エコデザインについて
2008. 11. 13	市ヶ谷セミ会議室	狛豊 安原光 宮代文夫 大西哲也	Siウエハを削る 固体電解質を用いた酸素センサ 海外学会での実装技術情報 海外での実装関連ワークショップの紹介
2010. 3. 3	市ヶ谷セミ会議室	宮代文夫	SiCデバイスとその周辺技術の国際会議情報
2010. 6. 11	市ヶ谷セミ会議室	加藤凡典	マーケットから見た実装技術
2010. 9. 15	市ヶ谷セミ会議室	塚田裕 橋本薫 田畑晴夫	フリップチップ/バンプ実装技術の現状 インジウムマイクロバンプの特性 鉄道模型
2010. 12. 8	市ヶ谷セミ会議室	鴨志田元孝 大西哲也 狛豊	最近のSiLSIデバイス・プロセス技術の動向 世界のLED実装技術の現状と動向 写真撮影技術
2011. 3. 15			3. 11東日本大震災のため中止
2011. 5. 31	市ヶ谷セミ会議室	中島信哉 和田毅	電気絶縁材ファイラーの変遷と技術動向 デジタルカメラの技術動向
2011. 9. 22	市ヶ谷セミ会議室	井上和夫 岡本明	磁場配向を用いた異方性導電ゴム フェライトのIEEEマイルストーンへの登録
2012. 1. 20	市ヶ谷セミ会議室	遠藤正徳 橋本薫 折井靖光	導電性ポリマーPEDCTとその応用 NJFと共催 3D実装の現状と展望
2012. 7. 23	市ヶ谷セミ会議室	傳田精一 西田秀行 宮代文夫 和田毅	TSV実装技術の最新動向 ACF実装について 初の全アジア実装国際会議ICEP-IAAC2012 将軍様の鉄道－北朝鮮の鉄道事情
2013. 2. 15	市ヶ谷セミ会議室 (NJFと共催)	宮代文夫 谷本智 舟木剛 宝蔵寺裕之	世界のSiC開発状況と日本の現状 高Tjドライブと高速スイッチング実現 SiC用デバイス用パッケージの開発 SiCデバイス用実装材料の開発例
2104. 2. 13	市ヶ谷セミ会議室 (NJFと共催)	田畑晴夫 傳田精一 本多進	国際学会における3D実装関連発表の推移 TSVによる3D, 2. 5D実装技術の動向と問題点 More than Moore 時代のインターポーザ のあるべき姿を探る